



台積公司董事會決議

發佈單位：台灣積體電路製造股份有限公司

發佈日期：2021年8月10日

台灣積體電路製造股份有限公司今（10）日召開董事會，重要決議如下：

- 一、核准配發 2021 年第二季之每股現金股利 2.75 元，其普通股配息基準日訂定為 2021 年 12 月 22 日，除息交易日則為 2021 年 12 月 16 日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自 2021 年 12 月 18 日起至 12 月 22 日止，停止普通股股票過戶，並於 2022 年 1 月 13 日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日亦為 2021 年 12 月 16 日，與普通股一致。台積公司美國存託憑證之配息基準日訂為 2021 年 12 月 17 日。
- 二、核准資本預算約美金 175 億 7,166 萬元（約新台幣 4,832 億 7,675 萬元），內容包括：1. 建置先進製程產能；2. 建置成熟及特殊製程產能；3. 建置及升級先進封裝產能；4. 廠房興建及廠務設施工程；5. 2021 年第四季研發資本預算與經常性資本預算。
- 三、核准追認捐贈五百萬劑 BNT162b2 疫苗予衛生福利部疾病管制署，用於台灣作為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫使用；以及預估不超過美金 1 億 7,500 萬元之疫苗總成本，包括疫苗採購、必要之冷鏈物流及處理服務與保險費用。
- 四、核准於不高於美金 10 億元之額度內於台灣國際債券市場募集美元無擔保普通公司債，並核准於不高於美金 80 億元之額度內，為本公司百分之百持有之海外子公司 TSMC Arizona 募集美元無擔保普通公司債提供保證，以支應本公司產能擴充之資金需求。
- 五、核准以下人事擢升案：
 1. 擢升本公司營運組織廠務處資深處長莊子壽博士為副總經理。
 2. 擢升本公司研發組織設計暨技術平台台積科技院士/資深處長魯立忠博士為台積科技院士/副總經理。

關於台積公司

台積公司成立於 1987 年，率先開創了專業積體電路製造服務之商業模式，自此成為世界領先的專業積體電路製造服務公司。台積公司以領先業界的製程技術及設計解決方案組合支援其客戶及夥伴生態系統的蓬勃發展，以此釋放全球半導體產業的創新。身為全球的企業公民，台積公司的營運範圍遍及亞洲、歐洲及北美，致力成為企業社會責任的行動者。

2020 年，台積公司提供最廣泛的先進製程、特殊製程及先進封裝等 281 種製程技術，為 510 個客戶生產 1 萬 1,617 種不同產品。台積公司為世界首家提供 5 奈米製程技術，即現今最先進的製程技術為客戶生產晶片的專業積體電路製造服務公司。其企業總部位於台灣新竹。進一步資訊請至台積公司網站 <https://www.tsmc.com.tw> 查詢。

#

台積公司發言人：

黃仁昭
副總經理暨財務長
Tel: 03-505-5901

台積公司新聞連絡人：

高孟華
企業公共關係部主管
Tel: 03-563-6688 ext. 712 5036
Mobile: 0988-239-163
E-Mail: nina_kao@tsmc.com

李國維
企業公共關係部
Tel: 03-563-6688 ext. 712 5037
Mobile: 0988-932-757
E-Mail: baker_li@tsmc.com

